

深圳市半导体行业协会

2024 中国（深圳）集成电路峰会 会议通知

各单位：

中国（深圳）集成电路峰会（以下简称 ICS 峰会）作为国内集成电路产业顶级盛会，致力于打造高水平、高标准的产业交流平台，邀请汇集众多国内外著名院士、行业专家和企业界，共同探讨新形势下集成电路产业的发展突破与时代机遇。ICS 峰会有助于促进集成电路产业链上下游深度交流与合作，在推动集成电路产业协同创新和高质量发展方面发挥重要作用。ICS 峰会每年定期在深圳召开，至今已成功举办十九届。

为进一步贯彻国家、省、市集成电路产业规划和政策，打造深圳品牌，彰显深圳特色，推动我市集成电路产业高质量发展，拟于 2024 年 8 月 15-17 日召开 ICS2024 峰会，具体内容如下：

一、组织架构

（一）指导单位：中国半导体行业协会设计分会；

（二）主办单位：深圳市人民政府；

（三）承办单位：深圳市发展和改革委员会、深圳市工业和信息化局、深圳市科技创新局、南山区人民政府；

（四）执行单位：深圳市半导体行业协会、电子元器件和集成电路国际交易中心；

（五）协办单位：中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会、国家集成电路设计深圳产业化基地、深圳国家“芯火”双创

基地、广东省集成电路行业协会、华强电子网、慧聪网、深圳中新材会展有限公司；

（六）支持单位：粤港澳大湾区半导体产业联盟、江苏省半导体行业协会、浙江省半导体行业协会、陕西省半导体行业协会、上海市集成电路行业协会、广州市半导体协会、重庆市半导体行业协会、厦门市集成电路行业协会、成都市集成电路行业协会、珠海市半导体行业协会、横琴半导体行业协会、东莞市集成电路行业协会等地方半导体行业协会；南方科技大学深港微电子学院、深圳技术大学微电子学院、深圳职业技术大学集成电路学院、深圳信息职业技术学院微电子学院、SEMI-e 深圳半导体展等；

二、会议安排

时间：2024 年 8 月 16 日（会期 1 天，外地代表 8 月 15 日报到）

地点：深圳南山

会议包括高峰论坛、专题论坛、产品技术展示三大板块

（一）高峰论坛

高峰论坛作为 ICS 峰会的重要内容，主要围绕集成电路领域最新市场动态、创新成果、国际国内产业形势、产业生态构建、技术演进趋势与应用、政产学研用与投融资等内容，邀请有关领导、院士、专家、企业家出席并做主题分享，共同探讨集成电路产业的突破发展与时代机遇，进一步推动我国集成电路产业高质量发展。

（二）专题论坛

围绕当前集成电路与半导体产业热点，峰会同期举办 IC 设计与创新应用、半导体制造与先进封装、EDA 创新生态发展三个专题论坛，论坛涵盖集成设计、制造、封测、材料、设备、EDA、IP 各个领域，通过搭建高标准的产业交流平台，邀请国内外龙头企业、高校、服务平台等参与，共同探讨新形势下集成电路产业的突破发

展与时代机遇。

（三）专题展览：产品与技术展示厅

峰会期间在公共区域设立产品与技术展示厅，重点关注 5G 通讯、人工智能、物联网、汽车电子等新兴产业，邀请国内外知名半导体与集成电路领域设计、封测、设备及服务类厂商参展，以物、图、文、音、像等多媒体为展示形式，集中展示我国集成电路产业最新的技术成果，为企业和参会者提供产品技术的交流平台，分享当前集成电路领域前沿技术和最新应用，促进产业链与创新链深度融合，发挥引领作用，为我国科技创新发展探索出“深圳经验”。

三、参会嘉宾

拟邀请相关政府主管单位领导，国内外著名院士、企业领袖、行业专家、基地和芯火平台负责人、协会负责人、投资机构负责人、产业链上下游企业代表等参会。

四、会务联系

寿爱华：0755-86169109，shouah@szsia.com

邹丹艳：0755-86156105，zuody@szsia.com

附件：日程安排

深圳市半导体行业协会

2024年7月8日

附件 1

日程安排

时间		会议安排	
8 月 15 日	9:00-22:00	全天外地嘉宾报到	
8 月 16 日	9:00-12:00	主论坛	高峰论坛
	13:30-17:30	专场论坛一	IC 设计与创新应用论坛
		专场论坛二	半导体制造与先进封装论坛
		专场论坛三	EDA 创新发展论坛
	9:00-18:00	专题展览	
	18:00-20:00	答谢晚宴（审核制）	
8 月 17 日	10:00-16:00	考察交流（邀请制）	